



Regensburg – das mittelalterliche Wunder Deutschlands!

Lernen Sie das UNESCO Weltkulturerbe kennen und genießen Sie die bayerische Gastlichkeit.

**SORAT Insel-Hotel
Müllerstraße 7
93059 Regensburg**

Organisation

Seminarmanagement

Dipl.-Phys. Helmut Reff
OTTI, Seminare und Fachforen
Bereich Technik
Wernerwerkstraße 4
93049 Regensburg
Telefon +49 941 29688-34
E-Mail: helmut.reff@otti.de

Zimmerreservierung

SORAT Insel-Hotel
Telefon +49 941 81040
www.sorat-hotels.com
oder
Tourist-Information
Regensburg
Telefon +49 941 507-4412
www.regensburg.de

Teilnahmegebühren und Leistungen

Fachforum mit Grundlagen (2½-tägig):
Pro Person: € 1390,00
OTTI-Mitglieder: € 1340,00
Fachforum (2-tägig):
Pro Person: € 1060,00
OTTI-Mitglieder: € 1010,00
Unternehmen aus Oberfranken, Niederbayern und der Oberpfalz:
(2½-tägig): € 1340,00
(2-tägig): € 1010,00

Der zweite Teilnehmer Ihrer Firma erhält **10 % Ermäßigung**, jeder weitere Teilnehmer Ihrer Firma erhält **20% Ermäßigung**.

In der Teilnahmegebühr sind Pausengetränke, zwei Mittagessen, eine Stadtführung, ein Abendessen und ausführliche Tagungsunterlagen (auch auf CD) enthalten.

OTTI-plus

Wichtige Kontakte knüpfen, Inhalte diskutieren, zwanglos Netzwerke aufbauen – nutzen Sie dafür das OTTI-Rahmenprogramm. Ein Abendessen im Kreise der Teilnehmer und Referenten, eine Stadtführung oder eine Besichtigung bieten Ihnen Freiraum für das Vertiefen von Fachfragen und das Aufgreifen von innovativen Ideen.

Ja, ich nehme teil am OTTI-Fachforum Kleben in der Elektronik

- Fachforum mit Grundlagen (2½-tägig):
23. bis 25. Januar 2012 in Regensburg (KETB 3995)**
- Nur Fachforum (2-tägig):
24. bis 25. Januar 2012 in Regensburg (KET 3994)**

Name _____	
Vorname _____	Titel _____
Telefon _____	Telefax _____
E-Mail _____	
Abteilung/Funktionsbereich _____	
Firma/Institution _____	
Straße/Postfach _____	
PLZ/Ort _____	
Rechnungsadresse (nur bei Abweichung von der Anmeldeadresse)	
Firma/Institution _____	
Straße/Postfach _____	
PLZ/Ort _____	
Branche _____	Zahl der Mitarbeiter _____
<input type="checkbox"/> Unternehmen aus Ostbayern	
OTTI-Kundennummer _____	USt-IdNr. _____
Datum _____	Unterschrift _____

**Ostbayerisches Technologie-Transfer-Institut e.V. (OTTI),
Wernerwerkstraße 4, 93049 Regensburg**

Teilnahme- und Rücktrittsbedingungen

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Teilnahmeunterlagen. Die Teilnahmegebühren sind mit Erhalt der Rechnung ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag vor dem Veranstaltungstermin. Veranstaltungseinlass kann nur gewährt werden, wenn die Zahlung bei OTTI eingegangen ist. Etwaige Änderungen aus dringendem Anlass behält sich OTTI vor. Bei Stornierung der Anmeldung bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn erheben wir keine Stornierungsgebühr. Bei Stornierung im Zeitraum von 30 bis 15 Tagen vor Veranstaltungsbeginn erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von € 120,00. Bei späteren Absagen (ab 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn) oder bei Fernbleiben wird die gesamte Teilnahmegebühr berechnet, sofern nicht von Ihnen im Einzelfall der Nachweis einer abweichenden Schadens- oder Aufwandshöhe erbracht wird. Die Stornoerklärung bedarf der Schriftform. Ein Ersatzteilnehmer kann zu jedem Zeitpunkt gestellt werden. Für Sach- und Vermögensschäden, welche OTTI zu vertreten hat, haftet OTTI – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Regensburg.

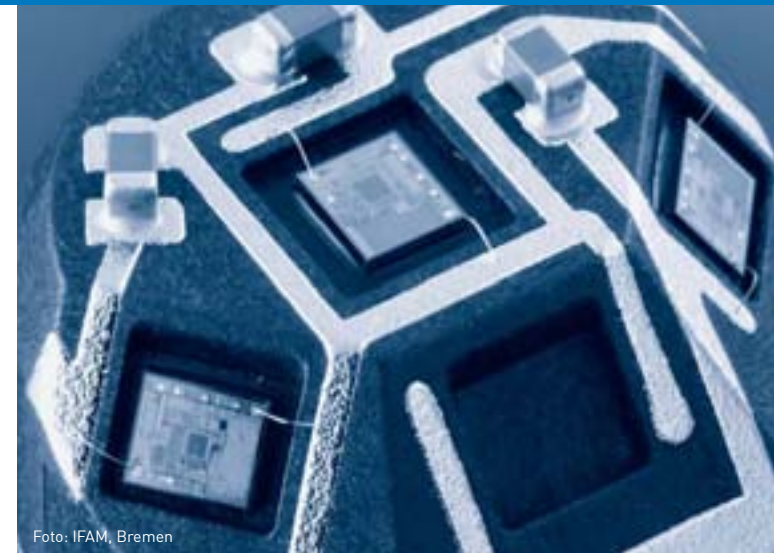


Foto: IFAM, Bremen

Kleben in der Elektronik

24. bis 25. Januar 2012 in Regensburg

Optional buchbar mit Einführung
Grundlagen des Klebens
23. Januar 2012 in Regensburg

www.otti.de

V-B-2011-10-18



OTTI  Training Seminare Tagungen

www.otti.de

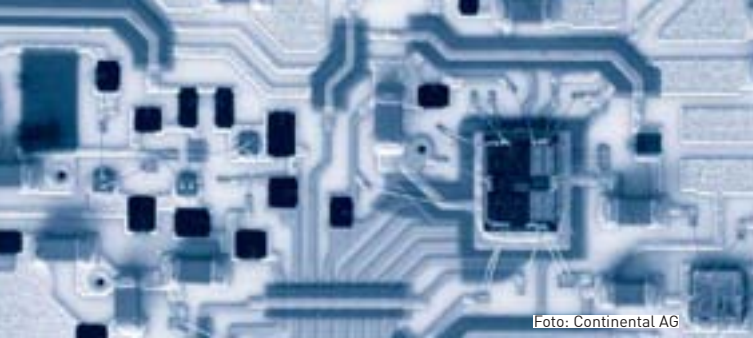


Foto: Continental AG

Fachforum



Kleben in der Elektronik

23. bis 25. Januar 2012 in Regensburg

Grundlagen (23. Januar 2012)

- Adhäsion, Oberflächen und Klebstoff-Chemie
- Elektrische, thermische, chemische und mechanische Eigenschaften von Klebstoffen
- Prüfung von Klebstoffen, Prozessen und Klebverbindungen

Fachforum (24. bis 25. Januar 2012)

- Verschiedene Klebstoffklassen und Füllstofftypen
- Automatisierte Fertigungstechniken zum Kleben
- Modellierung und Simulation
- Reinigung und Vorbehandlung von Oberflächen
- Kleben versus Löten
- Sicherheit des Klebprozesses
- Oberflächenanalysetechniken und Fehleranalytik
- Qualitätssicherung bei Klebungen
- Thermisch leitfähige Klebstoffe

Über 200 Veranstaltungen auf www.otti.de

Expertenwissen für Ihren Erfolg – profitieren Sie von praxisrelevanten Informationen durch sorgfältig ausgewählte Referenten und den erprobten Qualifizierungskonzepten in den OTTI-Veranstaltungen. Informationen zu allen aktuellen Seminaren, Fachforen und Tagungen finden Sie auf unserer Homepage unter www.otti.de

Programm

Grundlagen, (1/2-tägig)
23. Januar 2012, 13:00 bis 17:45 Uhr

1. Adhäsion, Oberflächen und Klebstoff-Chemie

- Oberflächen und Kontaminationen
 - Benetzung von Oberflächen
 - Klebstoffe als Polymere
 - Verfestigung der Klebstoffe
- Dipl.-Ing. Andrea Paul

2. Elektrische, thermische, chemische und mechanische Eigenschaften von Klebstoffen

- Volumen- und Kontaktwiderstand
 - Durchschlagsfestigkeit
 - Verformungsfähigkeit
 - Spannungsverteilung
 - Temperaturabhängigkeiten
- Dipl.-Ing. Andrea Paul

3. Prüfung von Klebstoffen, Prozessen und Klebverbindungen

- Oberflächenkontrolle
 - Qualität und Prozesskontrolle
 - Langzeitbeständigkeit und Alterung
- Dipl.-Ing. Andrea Paul

Fachforum (2-tägig)
24. Januar 2012, 09:00 bis 17:20 Uhr

1. Kleb- und Dichtverbindungen in der Automobilelektronik

- Anwendungsgebiete für Klebverbindungen
 - Einflussfaktoren und Anforderungen
 - Verbindungstechnik bei Klebungen
 - Anwendungsbeispiele
- Dr. Jens Heinrich

2. Schnelle Klebprozesse in der Elektronik

- Prozesse mit strahlungshärtenden Systemen
 - Prozesse mit Thermodenaushärtung
 - Prozesse mit Induktionshärtung
- Dr. Ralf Hose

3. Trends in der Verkapselung von mikroelektronischen Aufbauten

- Übersicht über aktuelle Verkapselungsverfahren
 - Chip on Board, Flip Chip, BGA etc.
- Dipl.-Ing. Tanja Braun

4. Damit es gut hält: Oberflächenanalytik beim Kleben in der Elektronik

- Anregungstiefe – Informationstiefe
 - Analytische Techniken
 - Reinigung und Aktivierung von Oberflächen
 - Fehleranalytik
- Dr. Birgit Hagenhoff

5. Sicheres Kleben in der Elektronikfertigung

- Fließverhalten und rheologische Phänomene von Klebstoffen
 - Qualitätssicherung bei Klebungen
 - Langzeitbeanspruchung – beschleunigte Alterung
- Dr. Klaus Höhn

6. Kleben mit automatisierter Fertigungstechnik

- Auswahlkriterien, Lieferformen und Verarbeitung
 - Materialaufbereitung, Mischen und Dosieren
 - Mechanische und thermische Kenngrößen
- N.N.

25. Januar 2012, 08:30 bis 16:00 Uhr

1. Klebstoff Auftragsverfahren

- Techniken zur Klebstoffapplikation
 - Dispensen gefüllter Klebstoffe im Sub-Nanoliter-Bereich
 - Einfluss des Mikroblasengehalts
- Dr. Thomas Gesang

2. Klebverbindungen in der Hochfrequenztechnik

- Klebstoffanwendungen in Mikrowellenmodulen
 - Hochfrequenzanforderungen an Klebverbindungen
 - Thermomechanischer Stress
 - Thermisches Management
- Dr. Matthias Bedenbecker

3. Vorteile und Anwendungen berührungsloser Mikrodosierertechnik

- Unterschied berührungslose – berührende μ -Dosiertechnik
 - Diverse „Ventiltriebe“
 - Entscheidungskriterien für den Einsatz
 - Hochgefüllte Klebstoffe – Probleme und Lösungen
- Jürgen Städtler

4. Prozesssicherheit beim Einsatz von UV-härtenden Klebstoffen

- UV-härtende Klebstoffsysteme
 - Aushärtung in Schattenbereichen
 - Prozesssicheres Aushärten
 - Inline Härtungskontrolle und punktgenaue UV-Aushärtung
- Dr. Stefanie Wellmann

5. Reinigen und Beschichten mittels Plasmen für Klebungen

- Grundlagen Plasmatechnik
 - Reinigung
 - Aktivierung
 - Beschichtung zur Haftvermittlung und zum Alterungsschutz
- Dr. Thomas Lukaszcyk

6. Auslegung von Klebverbindungen in der Elektronik

- Anforderungen bei Sensoren und Mikrosystemen
 - Modellierung und Simulation
 - Materialeigenschaften
 - Beispiele, experimentelle Verifikation
- Prof. Dr. Jürgen Wilde

Ihre fachliche Leitung



Dr. rer. nat. Thomas Gesang

Leiter Fertigungstechnologie und Klebtechnik für Mikrosysteme und Medizinanwendungen, Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM, Bremen.

Nach dem Physikstudium erwarb Herr Dr. Gesang Industrieerfahrung in Cambridge/UK bei der Entwicklung optischer Systeme sowie des Druckkopfes eines Inkjet Printers.

Seit 1989 ist Herr Dr. Gesang am IFAM auf dem Gebiet der Klebtechnik tätig. Er ist seit seiner

Promotion am Fachbereich Chemietechnik der Universität Dortmund in vielen Industrie- und öffentlichen Projekten zuständig für das Kleben in der Mikrofertigung, Medizintechnik und Elektronik.

Ihre Referenten

Dr.-Ing. Matthias Bedenbecker
CASSIDIAN MicroWave Factory,
Engineering & Logistics, Ulm

Dipl.-Ing. Tanja Braun
Encapsulation Technologies,
Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM), Berlin

Dr. Birgit Hagenhoff
Geschäftsführung, Tascon
GmbH, Münster

Dr. rer. nat. Jens Heinrich
Fertigungstechnologien,
Continental Automotive GmbH,
Regensburg

Dr.-Ing. Ralf Hose
Leiter Seminare und Schulungen, DELOIndustrie Klebstoffe GmbH, Windach

Dr. Klaus Höhn
Siemens AG, Corporate Technology, Corporate Research and Technologies, Erlangen

Dr. Thomas Lukaszcyk
Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung, IFAM, Bremen

Dipl.-Ing. (FH) Andrea Paul
Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM, Bremen

Jürgen Städtler
VERMES Microdispensing GmbH,
Geschäftsführer, Otterfing

Dr. Stefanie Wellmann
Geschäftsführung, Wellmann Technologies GmbH, Friedelsheim

Prof. Dr. Jürgen Wilde
Professur für Aufbau- und Verbindungstechnik, IMTEK Institut für Mikrosystemtechnik, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Teilnehmerkreis

- Fach- und Führungskräfte aus der Entwicklung, Produktion und dem Qualitätsmanagement der Elektronik- und Elektrotechnikindustrie
- Ingenieure, Techniker, Chemiker und Materialwissenschaftler aus dem Gebiet der Klebstoffe und Vergussharze und deren Anwendungen